

Пресс-релиз, 16 мая 2018 года, г. Москва

АО «РТСофт» анонсирует доступность модулей COM Express на базе Intel® Core™/Xeon® E 8-го поколения с 6 ядрами на борту и мощной графикой

АО «РТСофт» и международный холдинг Kontron AG, одновременно с объявлением коммерческой доступности чипов компании Intel, анонсируют старт продаж нового поколения «компьютеров-на-модуле» в стандарте PICMG COM.0 R3.0 COM Express Type 6 (COMe-bCL6) на базе 8-го поколения встраиваемых микропроцессоров компании Intel® Core™/Xeon® E (кодовое название – Coffee Lake), выполненных в соответствии с техпроцессом 14++ нм, с коммерческой доступностью не менее 7 лет.

Аппаратура COM Express на базе 8-го поколения Intel® Core™/Xeon® E устанавливает новые стандарты производительности, энергоэффективности, функциональности и защищенности для быстрой разработки самых разнообразных целевых приложений, где критически важно минимизировать важнейшие критерии концепции конструирования встраиваемого оборудования SWaP-C (габариты Size, вес Weight, энергопотребление Power и стоимость Cost) наряду с обеспечением высоких показателей надежности.

В линейку embedded микропроцессоров Intel, доступных для нового поколения COM Express, включены:

Xeon® E-2176M: 12 МБ SmartCache, 6 ядер 2,7/4,4 ГГц, GT2 Ultra HD P630, TDP 45/35 Вт, CM246;

Core™ i7-8850H: 8 МБ SmartCache, 6 ядер 2,6/4,3 ГГц, GT2 Ultra HD 630, TDP 45/35 Вт, QM370;

Core™ i5-8400H: 8 МБ SmartCache, 4 ядра 2,5/4,2 ГГц, GT2 Ultra HD 630, TDP 45/35 Вт, QM370.


Новые модули обеспечивают поддержку до 64 ГБ DDR4 2666 ECC со скоростью до 41,8 ГБ/с, имеют опциональный бортовой NVMe SSD до 1 ТБ, поддерживают работу трех независимых графических интерфейсов (DisplayPort/HDMI/eDP) с разрешением до 4096 x 2304 @ 60Гц и аппаратным кодированием/декодированием мультимедийного контента включая HEVC 10-бит.

Разработчики собственного целевого оборудования на основе модулей COMe-bCL6 по достоинству оценят удобства создания подсистем ввода/вывода на базе гибко конфигурируемого PCI Express 3.0, функционал 4 x USB 3.1 с поддержкой до 10 Гб/с Type C, развитость BIOS/EFI AMI Aptio V, поддержку Intel Optane и великолепные возможности архитектуры 8-поколения по администрированию, оптимизации, кибербезопасности и совместимости.

Модули COMe-bCL6 доступны в трех рабочих температурных диапазонах эксплуатации: от 0 до +60 0C, от -25 до +75 0C и от -40 до +85 0C, что гарантирует большой набор преимуществ по созданию совместимого оборудования самого широкого назначения.

Использование новых модулей гарантирует разработчикам максимум свободы и удобства в выборе операционных систем класса Windows, Linux, QNX, VxWorks, LynxOS и современных инструментальных средств разработки для реализации практически всех важнейших концепций применения передовой вычислительной техники подобного класса: IoT, IIoT, MIIoT и принципов конструирования ответственной COTS-аппаратуры.

Применение модулей COMe-bCL6 обеспечивает возможность быстро и бюджетно вывести на рынок конкурентоспособные конечные решения мирового уровня для промышленных, транспортных, телекоммуникационных, медицинских и иных приложений.



Модули доступны для заказа. Планируемый срок коммерческой доступности – не менее 7 лет, что делает их великолепной платформой для разработки любых критичных к надежности и длительности жизненного цикла приложений.

Модули COMe-bCL6 на базе поколения Coffee Lake Intel® Core™/Xeon® E будут валидированы для серийных отечественных промышленных платформ [BLOK Industrial](#) и [BLOK Rugged](#) в течение 3-го квартала 2018 года. Предсерийные образцы линеек BLOK для новых стартапов на базе Xeon E и Core i7 8-го поколения доступны для заказа уже сейчас.

С дополнительной информацией о модулях COMe-bCL6 можно ознакомиться на сайте www.kontron.com и в офисах компании «РТСофт» (www.rtsoft.ru), стратегического партнера холдинга Kontron в России и странах СНГ.

